

Pressa Calda Automatica Ad Alta Pressione 90 Ton 300X300Mm Piani 0,2% Precisione Pressione 200C

Numero articolo: XP65



introduzione

Scopri la pressa calda automatica ad alta pressione che eroga 90 tonnellate di forza su piani di 300×300 mm con una precisione di pressione dello 0,2% e un preciso controllo PID della temperatura fino a 200°C, ideale per la ricerca sulle batterie, l'incapsulamento dei semiconduttori, lo stampaggio di polimeri e la densificazione di compositi.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Laminazione Batterie a Stato Solido	Compatta gli strati dell'elettrodo e dell'elettrolita solido sotto alta pressione per ridurre la resistenza interfacciale, migliorando la conducibilità ionica e le prestazioni della cella. I profili di pressione a più fasi consentono cicli di laminazione ottimizzati senza danneggiare materiali delicati.	Raggiunge interfacce prive di difetti con una forza di 90 tonnellate.
Incapsulamento Semiconduttori	Esegue il bonding termocompressivo di precisione di substrati di grande formato, chip o materiali di incapsulamento a temperature controllate fino a 200°C. La pressione uniforme garantisce giunzioni affidabili e prive di vuoti, fondamentali per le tecnologie di incapsulamento avanzate.	Integrità e planarità del bond consistenti.
Stampaggio Polimeri	Stampa e polimerizza plastiche tecniche, PTFE, polietilene e fogli di gomma sotto elevata forza di serraggio e calore costante. I cicli programmabili garantiscono qualità ripetibile del pezzo e precisione dimensionale.	Pezzi ad alta densità e dimensionalmente accurati.
Densificazione Compositi	Consolida compositi rinforzati con fibre, prepreg e laminati utilizzando profili multistadio di calore e pressione per eliminare i vuoti e aumentare la frazione volumetrica delle fibre.	Resistenza meccanica e durata migliorate.
Laminazione Substrati Ceramici	Pressa nastri ceramici verdi multistrato per moduli LTCC/HTCC, garantendo spessore e adesione uniformi. La distribuzione uniforme della pressione previene crepe e delaminazioni.	Produzione ad alta resa di substrati affidabili.
Assemblaggio MEA Celle a Combustibile	Pressa a caldo gli assemblaggi membrana-elettrodo per celle a combustibile PEM, incollando gli strati catalitici alla membrana sotto temperatura e pressione precise per ottimizzare il confine trifase.	Prestazioni e durata ottimizzate.
Incollaggio Target di Sputtering	Incolla i target di sputtering alle piastre di supporto utilizzando alta pressione e calore, garantendo un'interfaccia forte e conduttiva che resiste ai cicli termici.	Incollaggio affidabile senza vuoti o punti caldi.
Laminazione Adesiva	Polimerizza adesivi strutturali tra materiali dissimili, come metallo e vetro, per componenti ottici o aerospaziali, utilizzando forza e calore controllati.	Incollaggi forti, otticamente trasparenti e senza bolle.

Parametro	Specifica	Note
Modello	XP65-90T3030	Pressa calda automatica ad alta pressione
Forza Massima	0 - 90 Tonnellate (900 kN)	Controllo idraulico a ciclo chiuso PIDS per applicazione di forza stabile
Precisione Sensore Pressione	±0,2%	Sensore ad alta precisione garantisce una deriva di pressione minima
Temperatura di Lavoro	0 - 200 °C (Max 200°C)	Ottimizzato per simmetria termica e planarità fino a 200°C
Controllo Temperatura	Regolatore PID programmabile	Interfaccia touchscreen a colori da 7 pollici per programmazione multi-fase
Potenza Riscaldamento	3500 W	Riscaldamento efficiente con basse perdite termiche
Dimensioni Piani	300 x 300 mm	Adatto per campioni fino a 300x300 mm
Pressione Superficiale Massima	~100 Bar (10 MPa)	Raggiunta a 90 tonnellate su tutta l'area del piano

Parametro	Specifica	Note
Alimentazione Elettrica	AC 220V / 50Hz (monofase)	Richiede un circuito dedicato da 16A per un funzionamento sicuro
Dimensioni (LxPxA)	600 x 520 x 650 mm	Ingombro compatto da banco
Peso	350 kg	Costruzione pesante per rigidità; assicurarsi che il banco supporti il peso